

 			
이 자료는 수령 즉시 보도해 주시기 바랍니다.			
배포일자	2026년 4월 30일 목요일	담당부서	미래반도체실
담당실장	김병재 실장(053-718-8406)	담당자	최서진 책임(053-718-8397)

산기평, 첨단 반도체 신규 연구개발 본격 착수... 협약 및 성과 창출 지원사격

한국산업기술기획평가원(원장 직무대행 서용원, 산기평)은 지난 29일 우리나라 반도체 산업의 초격차 확보를 선도할 2026년도 반도체 분야 신규 연구개발 과제를 대상으로 협약설명회를 개최했다.

이번 설명회는 지난 1월 산업통상부가 공고한 반도체 첨단산업 기술 개발, 반도체 첨단 패키징(Packaging) 선도 기술 개발, 민관 공동 투자 반도체 고급 인력 양성, 시장 선도를 위한 한국 주도형 K-센서 기술 개발, 시스템 반도체 기업 성장 사다리 조성 등 총 5개 사업의 신규 선정된 과제 연구자들을 대상으로 진행됐다.

산업부와 산기평은 올해 총 524억원을 지원해, 반도체 첨단산업 생태계 지원, 첨단 패키징(Packaging) 전략기술 확보, 주력산업 데이터 수집·처리용 센서, 산업 현장형 고급 인재 육성 등을 통해 첨단 반도체 산업의 초격차를 이끌어갈 계획이다.

이번 설명회는 연구 현장에서 필수적인 법령과 규정 안내는 물론, 기

업별 맞춤형 상담과 연구개발 법률 지원 등 국가연구개발사업 전주기를 아우르는 밀착 지원 체계를 구축하는 데 주력했다. 특히 연구자들이 현장에서 겪는 실질적인 애로사항을 청취하고 즉각적인 해법을 모색하는 양방향 소통의 장이 되었다는 평이다.

산기평 장종찬 첨단산업본부장은 “미국과 중국을 중심으로 반도체 공급망 재편과 기술 패권 경쟁이 격화되고 있다”며, “이번 신규 연구개발 과제가 국내 반도체 산업 경쟁력 강화에 핵심 동력이 될 것”이라고 강조했다. 이어, “앞으로도 현장의 목소리를 정책에 적극 반영하여, 연구자들이 성과 창출에 몰입할 수 있는 지속가능한 연구개발 생태계를 구축하겠다”고 덧붙였다.

내일을 바꾸는 기술, 내일을 빛내는 청력